

MSAPに最適なビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤

トップルチナVT

Additives for Acid Copper Plating to Via-filling (For MSAP)

TOP LUCINA VT

- ▶優れたビアフィリング性能と高いスルーホールめっき性能の両立が可能
- ▶浴組成のハイスロー化に対応することで良好な膜厚均一性を実現
- ▶全ての添加剤成分の定量分析が可能

- Realize great performances in via-filling and through-hole plating
- Applicable to bath for high throwing power, great uniformity in film thickness
- Quantitative analysis is possible for all additives

ビアフィリング性能に優れ、浴組成のハイスロー化に対応

Great via-filling performance, applicable to bath for high throwing power

硫酸銅五水和物:200g/L

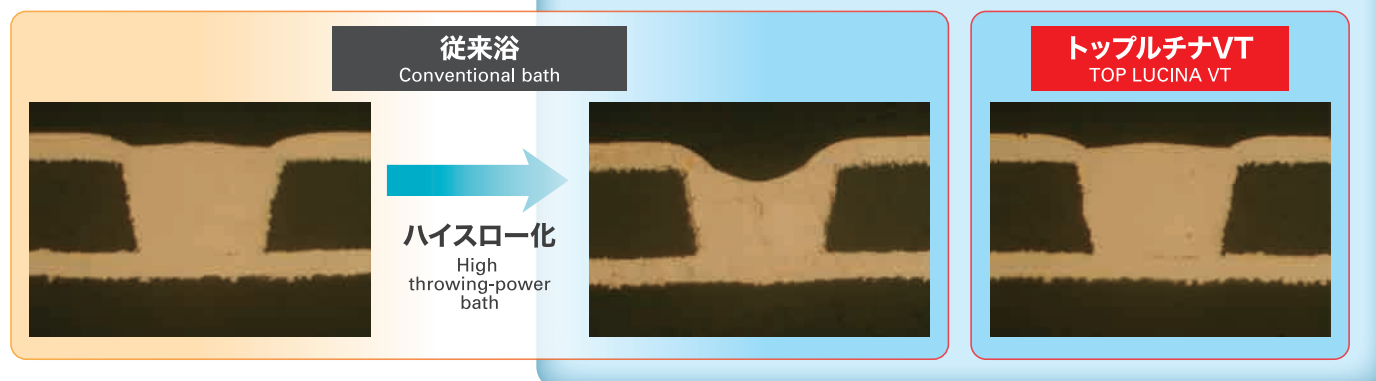
硫酸:50g/L

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}:200\text{g/L}$ $\text{H}_2\text{SO}_4:50\text{g/L}$

硫酸銅五水和物:150g/L

硫酸:150g/L

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}:150\text{g/L}$ $\text{H}_2\text{SO}_4:150\text{g/L}$

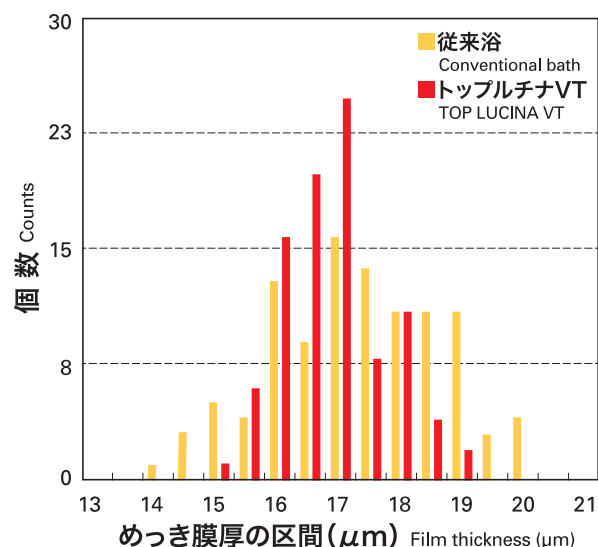


電流密度:2.0A/dm² 穴径 110 μm ビア深さ 60 μm

Current density:2.0A/dm² Via hole diameter:110 μm Via hole depth:60 μm

膜厚分布に優れる

Great uniformity in film thickness



高スローイングパワー

Great throwing power

